

北京赛微电子股份有限公司

关于控股子公司 MEMS 生物芯片通过验证并启动试产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 1 月 10 日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（简称“赛莱克斯北京”）代工制造的某款 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统）生物芯片通过了客户验证，该客户已同步签署试产订单，启动首批 MEMS 生物芯片 8 英寸晶圆的小批量试生产。

生物微机电系统（BioMEMS）是指生物学工程与 MEMS 工程的交叉学科及应用，所对应的各类芯片系统涉及微传感器、微驱动器、微流体系统、微光学系统及微机械元件等，可在生物学、医学和生物学工程等领域广泛应用。本次试产的 MEMS 生物芯片属于一款具体产品及应用。MEMS 生物芯片与相应检测仪器配合使用，通过 MEMS 工艺技术在芯片表面构建微型生物化学分析系统，从而实现对生命机体的生物组分进行准确、快速、大量的信息检测，可广泛应用于基因测序等多种精准医疗检测场景。

MEMS 制造工艺可以在微小的生物芯片中加工微纳米级别的泵、阀、管道、容器等，将生物传感器的复杂功能集成内置在芯片中，同时可以实现生物芯片的高灵敏度、高准确性、微创应用及低成本、大批量生产。赛莱克斯北京通过自身对材料与工艺的深刻理解，自主创新 MEMS 制造工艺的应用，成功地在产线上实现硅衬底与玻璃衬底的兼容，并在此基础上完成加工制造过程。

近年来，赛莱克斯北京持续加大研发投入，自主积累基础工艺，积极探索各类 MEMS 器件的生产诀窍，努力为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等领域客户，尤其是中国本土客户提供优质的 MEMS 工艺开发及晶圆制造服务，积极推动公司在本土形成和提升自主可控的 MEMS 生产制造能力，加速国产替代。

尽管通过全员努力，已在多领域实现 MEMS 制造技术的积累和突破，但赛莱克斯北京客观上仍处于运营初期，产线的产能爬坡、良率提升是一个持续的过程，产能的继续扩充以及产量目标的实现尚需一定时间。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日